

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-34

| | |
|-----------------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（_____） |
| 活动参与人员（排名不分先后） | <p>嘉实基金、大成基金、建信基金、长盛基金、易方达基金、诺德基金、博时基金、银华基金、民生加银基金、汇添富基金、太平基金、中庚基金、国泰基金、长安基金、惠升基金、永赢基金、施罗德基金、创金合信基金、国融基金、中信保诚基金、国投瑞银基金、泰康基金、新华基金、财通基金、瑞士银行、野村证券、摩根证券投资信托、工银资管(全球)、深圳市前海博普资管、深圳市中颖投资、上海高毅资管、上海石丸梨花私募基金、上海泾溪投资、上海亘曦私募基金、上海笃熙禀泰私募基金、华杉瑞联基金、闻天私募证券投资基金、西藏中睿合银投资、上海安洪投资、北京神农投资、上海景领投资管理、上海潼骁投资、上海敦颐资管、上海张江科技创业投资、北京衍航投资、西安瀑布资产、上海博笃投资、江苏瑞华投资、深圳前海荣德金资管、广东正圆私募基金、上海盘京投资管理中心（有限合伙）、苏州工业园区元禾重元股权投资基金、深圳中安汇富私募证券投资基金、上海狮云私募基金、鲍尔赛嘉(上海)投资管理、江苏沣沃私募基金、深圳市兴亿投资、深圳市尚诚资管、上海世亨私募基金、盛钧私募基金管理(湖北)、华西银峰投资、知远投资、长城证券、国元证券、山西证券、上海证券、华创证券、中国国际金融、东海证券、中银国际证券、西部证券、国信证券、中国银河证券、招商证券、开源证券、野村东方国际证券、汇丰前海证券、摩根大通证券（中国）、华泰证券、财通证券、东方证券、第一上海证券、华源证券、中泰证券、兴业证券、甬兴证券、海通证券、国盛证券、中信证券、华福证券、国投证券、浙商证券、华西证券研究所、中信证券资产、野村国际(香港)、长江证券（上海）资产、前海再保险、路博迈基金、昆仑健康保险、长城财富保险资管、东亚前海证券、天风证券、光大证券、上海国际信托、华能贵诚信托、高盛（中国）证券、浩成资管、奇点资管、清池资本（香港）、泓铭资本金融、Grand Alliance Asset Management、花旗环球金融亚洲有限公司、平安证券、北京禹田资本、上海禾昇投资、美林（亚太）、Morgan</p> |

| | |
|---------------|---|
| | Stanley、上海投延、国华兴益保险资产管理、招商信诺资产、上海汽车集团金控、深圳市辰禾投资 |
| 上市公司接待人员 | 副总经理、董事会秘书：张丽君；战略发展部总监、证券事务代表：谢丹； |
| 时间 | 2025 年 10 月 29 日 |
| 地点 | 网络及电话会议、公司会议室 |
| 形式 | 网络及电话会议 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>交流主要内容：</p> <p>Q1、请介绍公司 2025 年三季度经营业绩情况。</p> <p>2025 年三季度，公司实现营业收入 63.01 亿元，同比增长 33.25%，归母净利润实现 9.66 亿元，同比增长 92.87%，扣非归母净利润累计实现 9.16 亿元，同比增长 94.16%。</p> <p>上述变动主要得益于公司把握 AI 算力升级、存储市场结构性增长、汽车电子智能化的需求增加的发展机遇，实现了主营业务收入的同比增长。其中，AI 加速卡、交换机、光模块、服务器及相关配套产品需求持续提升，存储类封装基板产品把握结构性增长机遇，订单收入进一步增加。公司加大各业务市场开发力度，产品结构优化、产能利用率提升，助益利润同比增长。</p> <p>Q2、请介绍 2025 年三季度综合毛利率环比变化情况。</p> <p>2025 年第三季度，公司综合毛利率环比有一定改善，主要得益于存储类封装基板需求增加，封装基板产能利用率提升，广州广芯工厂爬坡稳步推进，使得封装基板营收规模增长、毛利率改善显著；同时，PCB 数据中心、有线通信业务收入持续增长，毛利率略有提升。上述因素共同助力公司综合毛利率的提升。</p> <p>Q3、请介绍 2025 年第三季度 PCB 业务各下游领域经营拓展情况。</p> <p>公司 PCB 业务产品下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。2025 年第三季度，数据中心、有线通信业务收入持续增长，各业务领域占比与上半年基本一致。</p> |

Q4、请介绍 2025 年第三季度封装基板业务经营拓展情况。

公司封装基板业务产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。2025 年第三季度，封装基板营业收入环比增加，各下游领域产品需求均有增长，其中存储类封装基板增长最为显著。

Q5、请介绍公司南通四期及泰国项目规划及当前建设进展。

公司新建工厂包括南通四期及泰国工厂，泰国工厂目前已连线试生产，南通四期在今年四季度连线。南通四期和泰国工厂将具备高多层、HDI 等 PCB 工艺技术能力，其建设将助力 PCB 业务产能进一步释放。

Q6、请介绍公司 2025 年第三季度工厂产能利用率较第二季度变化情况。

公司综合产能利用率仍处于相对高位。2025 年三季度，PCB 业务总体产能利用率仍处于高位；封装基板业务因存储市场及应用处理器芯片类产品需求的增长，工厂产能利用率环比明显提升。

Q7、请介绍原材料价格变化情况及对公司的影响。

公司主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、金盐、油墨等，涉及品类较多。2025 年三季度，受大宗商品价格变化影响，金盐、铜等部分原材料价格环比增长。公司将持续关注国际市场大宗商品价格变化以及上游原材料价格传导情况，并与供应商及客户保持积极沟通。

Q8、请介绍公司 2025 年三季度研发投入情况。

2025 年三季度公司研发投入金额约 4.64 亿元，占公司营收比重为 7.37%。公司各项研发项目进展顺利，下一代通信及数据中心相关 PCB 技术研发、FC-BGA 基板产品能力建设、FC-CSP 精细线路基板技术能力提升等项目均按期稳步推进。

Q9、请介绍公司封装基板业务在 FC-BGA 技术能力方面取得的进展。

公司 FC-BGA 封装基板已具备 20 层及以下产品批量生产能力，22~26 层以上产品具备

| | |
|-----------------------------|---|
| | <p>样品制造能力。公司后续将进一步加快高阶领域产品技术能力突破和市场开发，同时也将继续引入该领域的技术专家人才，加强研发团队培养，提升巩固核心竞争力。</p> <p>Q10、请介绍无锡新地块规划。</p> <p>该地块为 PCB 业务算力相关产品的储备用地，预计分期投入，具体投资将根据业务发展和市场情况推进实施。</p> |
| <p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p> | <p>调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p> |
| <p>附件清单</p> | <p>无</p> |